

# 山东天岳先进科技股份有限公司

## 投资者关系活动记录表

证券简称：天岳先进

证券代码：688234

编号：2023-009

|               |  |
|---------------|--|
| 投资者关系活动类别     | <input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访<br><input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演<br><input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他   |
| 参与单位名称        | 见附件清单  |
| 时间            | 2023年11月23日、2023年11月24日  |
| 地点            | 现场交流及通讯会议  |
| 接待人员          | 董事、董事会秘书：钟文庆<br>证券事务代表：马晓伟   |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p><b>第一部分：介绍公司相关情况</b></p> <p>简要介绍了公司的发展历程、主要产品及应用领域、2023年前三季度经营情况、技术研发进展情况、产能规划布局情况、客户合作情况、订单签署及履行情况、未来市场机遇及发展计划等内容。</p> <p><b>第二部分：交流环节的主要问题及回复</b></p> <p><b>问题 1：公司与英飞凌合作的情况如何？</b></p> <p>回复：公司十分高兴能与全球功率半导体领域的领导者英飞凌展开合作，为英飞凌供应高质量的碳化硅衬底产品。根据前期英飞凌官网报道，公司将为英飞凌供应高质量并且有竞争力的6英寸碳化硅衬底，第一阶段将侧重于6英寸碳化硅材料，但公司也将助力英飞凌向8英寸碳化硅晶圆过渡，供应量预计将占到英飞凌长期需求量的两位数份额。截至目前，公司与英飞凌的合作顺利，我们也正在按照订单的约定交付产品。</p> <p><b>问题 2：碳化硅材料未来是否可能会被其他材料替代？</b></p> <p>回复：我们相信半导体材料肯定是不停往前发展的，每一代材料都会有自己最合适的利用价值和最合适的市场。我们也在持续关注未来的材料发展方向，目前来看碳化硅半导体材料还处于产业化应用的起步阶段，未来的发展空间良好，公司也将持续加大研发投入、加快产品迭代、提升产品质量，并积极做好前瞻性技术布局，致力于成为国际宽禁带半导体行业的领军企业。</p> |

|          |  |
|----------|--|
|          | <p><b>问题 3：公司在研发方面有何布局？</b><br/> 回复：加强研发创新是公司的既定战略。碳化硅半导体产业链发展进入快车道，衬底制备是产业链的关键环节，公司为继续保持在全球技术和产品竞争中的领先优势，持续加强研发投入。公司在 8 英寸导电型产品产业化研发，液相等前瞻技术研发，大尺寸半绝缘产品研发，以及高品质导电型产品等方面持续加大研发投入，继续加大前沿技术布局，研发实力不断增强。</p> <p><b>问题 4：中期来看，是衬底的公司更有优势还是做器件的公司会更有优势？</b><br/> 回复：我们也关注到市场有很多家企业宣布要做碳化硅衬底，对此我们是谨慎乐观的态度。乐观的是大家对碳化硅的认识比较统一，市场上都逐渐了解碳化硅优异的物理性能、广泛的下游应用领域等等。但另一方面，碳化硅衬底产业不仅存在一定的资本门槛，更存在着很高的技术门槛，对技术迭代，经验积累和产业化过程中对产品质量的一致性的要求都非常高，这将会是很大的挑战。<br/> 公司努力通过技术提升和规模化生产，加快推动碳化硅材料和技术的渗透应用，在绿色化、低碳化、智能化、电气化时代，碳化硅将发挥更加重要的作用。</p> |
| 附件清单（如有） | 参会机构名单   |
| 日期       | 2023 年 11 月 23 日、2023 年 11 月 24 日  |
| 备注       | 参加投资者接待活动中，公司管理层积极回复投资者提出的问题，回复的内容符合公司《信息披露管理制度》等文件的规定，回复的信息真实、准确。   |

件：参会机构名单

| 序号 | 机构   | 序号 | 机构   |
|----|------|----|------|
| 1  | 淡水泉  | 2  | 嘉实基金 |
| 3  | 长江养老 | 4  | 碧云资本 |